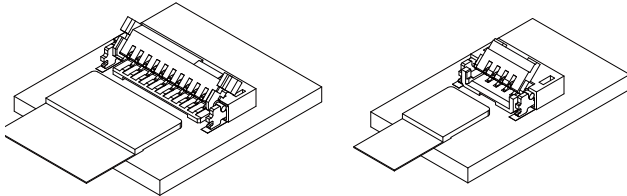


FHSY CONNECTOR

0.5mmピッチ / プリント基板用 / FPC用・ZIFタイプ



*FHSY-RSM1-GAN

04FHSY-RSM1-GAN(HF)(NN)

実装高さ 0.9mm の低背で、標準 FPC 厚さ 0.3mm に対応した、ZIF フリップロックタイプの FPC 接続用コネクタです。

- ・省スペース
- ・表面実装に最適な耐熱設計
- ・エンボステーピングで自動実装に対応

登録規格

海外登録規格の取得有無については弊社までお問い合わせください。

一般仕様

- ・定格電流: 0.5A AC/DC
- ・定格電圧: 50V AC/DC
- ・使用温度範囲: -25°C ~ +85°C (通電時の温度上昇値を含む)
- ・接触抵抗: 初期 / 60mΩ 以下
耐熱性試験後 / 60mΩ 以下 (初期からの変化量)
- ・絶縁抵抗: 500MΩ 以上
- ・耐電圧: AC 200V を 1 分間印加にて絶縁破壊なきこと
- ・適用 FPC: 導体ピッチ / 0.5mm
導体幅 / 0.35mm
接触部厚さ / 0.3 ± 0.03mm¹
【形番末尾 (NN) は ± 0.05 適用¹】

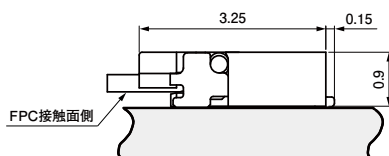
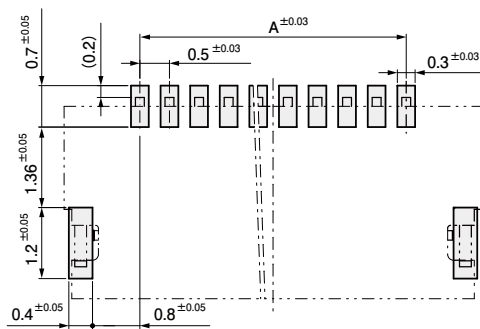
※ご使用に際しては、弊社ウェブサイト (製品情報ページの技術資料末項) に記載のご使用上の注意事項を参照ください。

※RoHS2 対応品を掲載しています。

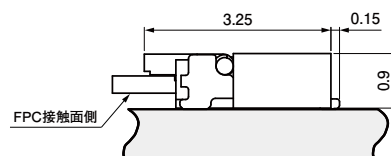
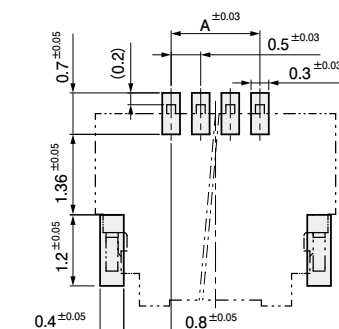
※寸法の単位には mm を採用しています。

※詳細は弊社までお問い合わせください。

基板レイアウト・組立レイアウト



*FHSY-RSM1-GAN



04FHSY-RSM1-GAN (HF) (NN)

注 1) A 寸法: 2 ページのコネクタの項を参照ください。

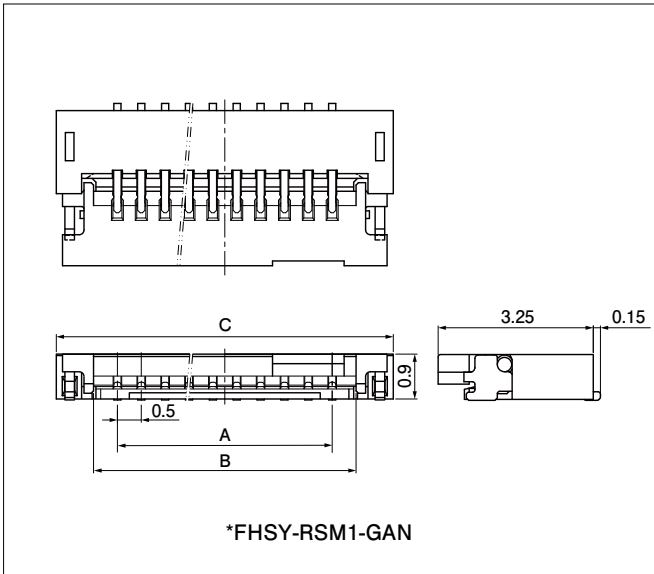
注 2) 基板レイアウトはコネクタ装着側から見た図です。

注 3) 基板のパターンピッチは公差 ± 0.03 で累積しないこと。

上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

FHSY CONNECTOR

コネクタ

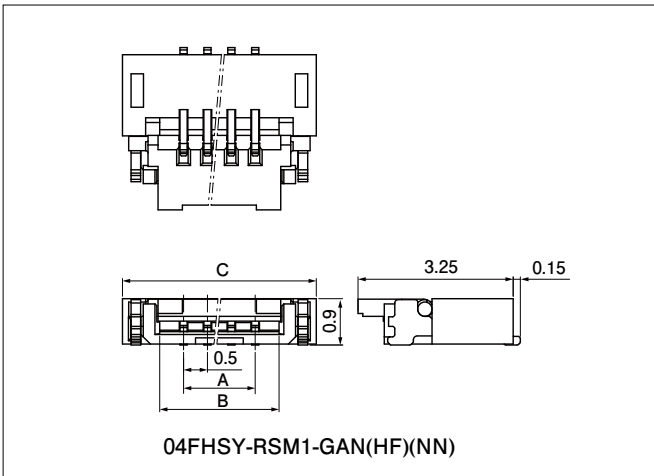


極数	形番	寸法 (mm)			個数/リール
		A	B	C	
5	05FHSY-RSM1-GAN-TB	2.0	3.0	4.56	3,000
6	06FHSY-RSM1-GAN-TB	2.5	3.5	5.06	3,000
8	08FHSY-RSM1-GAN-TB	3.5	4.5	6.06	3,000
10	10FHSY-RSM1-GAN-TB	4.5	5.5	7.06	3,000
11	11FHSY-RSM1-GAN-TB	5.0	6.0	7.56	3,000
12	12FHSY-RSM1-GAN-TB	5.5	6.5	8.06	3,000
14	14FHSY-RSM1-GAN-TB	6.5	7.5	9.06	3,000
15	15FHSY-RSM1-GAN-TB	7.0	8.0	9.56	3,000
16	16FHSY-RSM1-GAN-TB	7.5	8.5	10.06	3,000
17	17FHSY-RSM1-GAN-TB	8.0	9.0	10.56	3,000
18	18FHSY-RSM1-GAN-TB	8.5	9.5	11.06	3,000
20	20FHSY-RSM1-GAN-TB	9.5	10.5	12.06	3,000
22	22FHSY-RSM1-GAN-TB	10.5	11.5	13.06	3,000
24	24FHSY-RSM1-GAN-TB	11.5	12.5	14.06	3,000
27	27FHSY-RSM1-GAN-TB	13.0	14.0	15.56	3,000
28	28FHSY-RSM1-GAN-TB	13.5	14.5	16.06	3,000

材 料・表面処理等

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金部分めっき
 カバーハウジング：耐熱性樹脂(ブルー)
 ソケットハウジング：耐熱性樹脂(ナチュラル)
 補強タブ：銅合金・銅下地付すずめっき

本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。



極数	形番	寸法 (mm)			個数/リール
		A	B	C	
4	04FHSY-RSM1-GAN-TB(HF) (NN)	1.5	2.5	4.06	6,000

材 料・表面処理等

コンタクト：銅合金・ニッケル下地付金部分めっき
 カバーハウジング：耐熱性樹脂(グレー)
 ソケットハウジング：耐熱性樹脂(ナチュラル)
 補強タブ：銅合金・銅下地付すずめっき

FPC リード部寸法

